

2022年3月期 決算説明

2022年5月20日



東証プライム 7537

1. 2022年3月期 連結決算の概要

2. 2022-2024年度 中期経営計画

3. 2023年3月期 業績予想の概要

4. 参考資料

2022年3月期 連結決算の概要

2022年3月期 決算サマリ（前年度比）

- ▶ 商権の拡大や電子部品、産業機器、レーザ機器の需要増により売上が伸長
- ▶ 急速な円安進行で為替差損を計上したものの、経常利益・当期純利益は大幅な増益を達成

(百万円)	2021年3月期 (従来基準)		2022年3月期 (従来基準)		前年度比	2022年3月期 (収益認識基準)
	実績	売上比	実績	売上比		
売上高	289,283	—	313,816	—	+24,533 (+8.5%)	167,794
売上総利益	16,217	5.6%	21,198	6.7%	+4,981 (+30.7%)	20,251
販管費	15,193	5.3%	14,257	4.5%	△936 (-6.2%)	14,257
営業利益	1,023	0.4%	6,940	2.2%	+5,917 (+578.4%)	5,994
経常利益	33	0.0%	3,684	1.1%	+3,651 (—)	4,106
親会社株主に帰属 する当期純利益	△2,133	—	2,015	0.6%	+4,148 (—)	2,437

2022年3月期 決算サマリ（業績予想比）

- ▶ 民生機器向け半導体が好調に推移し、売上高は上振れ
- ▶ 円安進行に伴う為替差損の計上により、経常利益・当期純利益は未達

(百万円)	2022年3月期予想 (2021年10月発表)		2022年3月実績 (収益認識基準)		業績予想比
	実績	売上比	実績	売上比	
売上高	163,000	—	167,794	—	+ 4,794
売上総利益	19,200	11.8%	20,251	12.1%	+ 1,998
販管費	14,200	8.7%	14,257	8.5%	+ 57
営業利益	5,000	3.1%	5,994	3.6%	+ 994
経常利益	4,500	2.8%	4,106	2.5%	△ 394
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,900	1.8%	2,437	1.6%	△ 463

■ デバイス事業

民生・産業機器向け電子部品や通信機器向け特定用途ICが増加

(百万円)	2021年3月期実績 (従来基準)	2022年3月期実績 (従来基準)	前年度比	2022年3月期 (収益認識基準)
売上高	242,050	262,279	+20,229 (+8.4%)	117,568

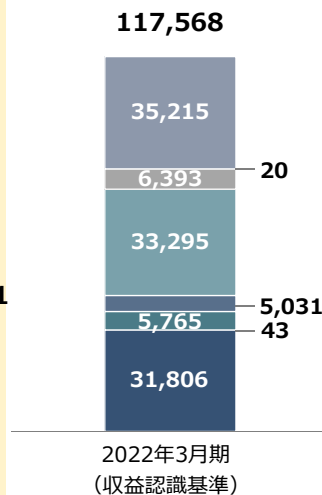
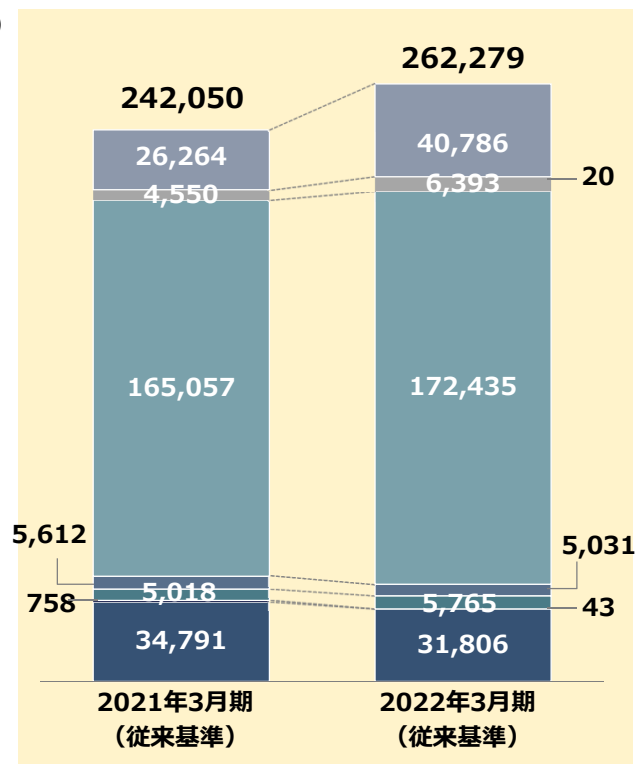
■ システム事業

産業機器やレーザー機器、医用機器が好調に推移

(百万円)	2021年3月期実績 (従来基準)	2022年3月期実績 (従来基準)	前年度比	2022年3月期 (収益認識基準)
売上高	47,233	51,537	+4,304 (+9.1%)	50,225

2022年3月期 『デバイス事業』 品目別売上高

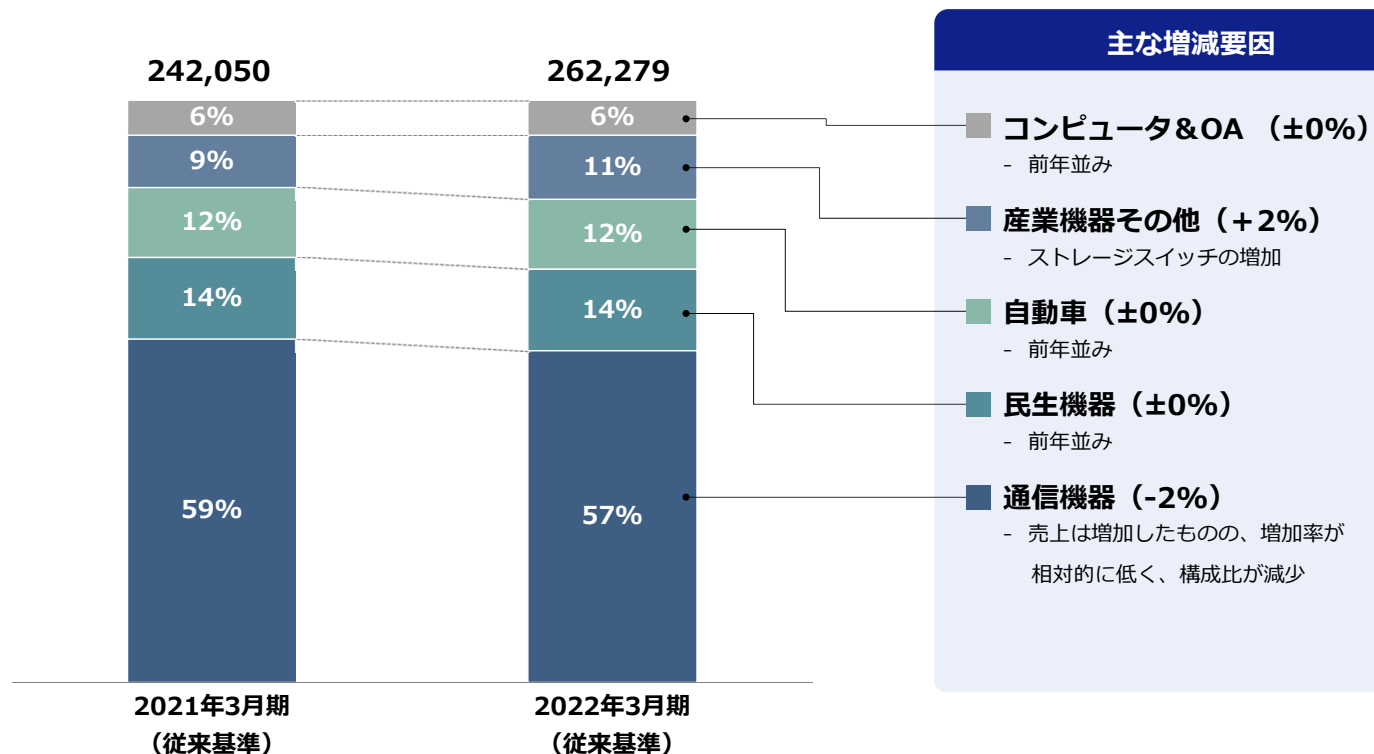
(百万円)



主な増減要因

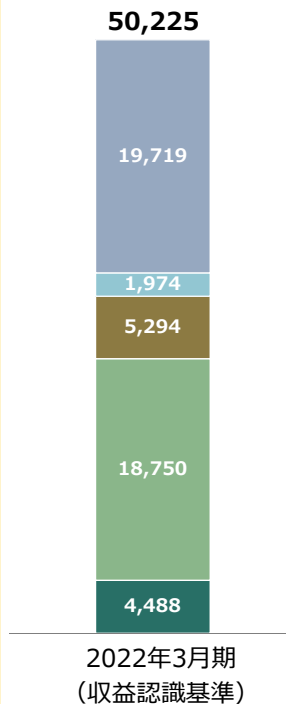
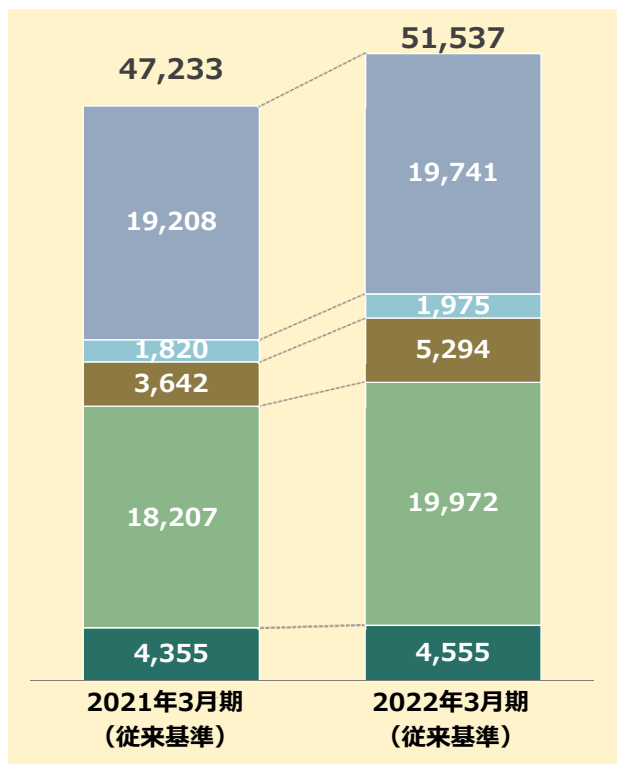
- **電子部品 (+14,522)**
 - 民生・産業機器向け部品、ソフトウェア製品の増加
- **半導体その他 (+20)**
 - 前年並み
- **カスタムIC (+1,843)**
 - PC関連機器向けの増加
- **特定用途IC (+7,378)**
 - 通信機器向けの増加
- **マイクロプロセッサ (△581)**
 - 産業機器向けの減少
- **メモリーIC (+746)**
 - 自動車向けの増加
- **標準ロジック (△716)**
 - 産業機器向けの減少
- **アナログIC (△2,985)**
 - 自動車・産業機器向けの減少

2022年3月期 『デバイス事業』 用途別動向



2022年3月期 『システム事業』 品目別売上高

(百万円)



主な増減要因

- 医用機器 (+533)**
 - 画像診断装置の増加
- 情報通信機器 (+154)**
 - 前年並み
- レーザ機器 (+1,652)**
 - 産業機器組み込み用半導体レーザの増加
- 産業機器 (+1,765)**
 - 電子部品組立検査装置の増加
- 航空宇宙機器 (+200)**
 - 前年並み

2022年3月期 貸借対照表の概要

▶ 総資産は、未収入金の増加等により前期末に比べ211億円増加の1,481億円

(百万円)	2021年3月期	2022年3月期	前期末比
資産合計	127,006	148,179	+21,173
流動資産	114,804	137,604	+22,800
現金及び預金	26,874	25,245	△1,629
受取手形及び売掛金	51,058	44,215	△6,843
商品及び製品	34,174	30,313	△3,861
未収入金	596	35,087	+34,491
固定資産	12,202	10,575	△1,627
負債合計	81,966	100,604	+18,638
流動負債	76,165	94,746	+18,581
支払手形及び買掛金	30,298	21,121	△9,177
短期借入金	42,194	48,672	+6,478
未払金	1,349	21,855	+20,506
固定負債	5,801	5,858	+57
純資産合計	45,040	47,574	+2,534

2022-2024年度 中期経営計画

- 丸文 Nextage 2024 -

前中期経営計画（2019～2021年度）の振り返り 一業績一

- ▶ 新型コロナウイルス感染症による影響を受けたものの、高付加価値商品の伸長により収益性が向上し、中期目標のROE5.0%以上を達成

(百万円)	2018年度 (基準年度)	2021年度 (収益認識基準)
売上高	3,266 億円	1,678 億円
経常利益	30 億円	41 億円
経常利益率	0.9 %	2.5 %
ROE	3.8 %	5.9 %

前中期経営計画（2019～2021年度）の振り返り —基本方針—

- ▶ 事業ポートフォリオの転換や成長市場向けの商材開発は進んだものの、ESGを通じた事業機会創出の取り組みは構築途上

基本方針	取り組み成果
<p>新たな価値を創造する ビジネスモデルの構築</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新たなビジネスとしてAIロボットの導入やソフトウェア販売を開始し、事業ポートフォリオの転換を進めた
<p>成長市場に向けた 事業開発の促進</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ デジタル化が進む医療・介護市場向けの商材・サービスを拡充 ■ ローカル 5Gなど先端かつ高性能な商材開発を促進
<p>持続可能な社会に貢献する 取り組みの強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ サステナビリティ委員会を設置したが、具体的な取り組みや事業機会の創出はこれから

アクションプランの振り返り

	重点施策	取り組み成果
デバイス事業	1 高付加価値ビジネスの推進	<ul style="list-style-type: none"> ■ 既存仕入先でのラインカードの拡充、アナログ商材を中心に新規仕入先の開発を促進し、収益性が改善
	2 成長市場での事業拡大	<ul style="list-style-type: none"> ■ IoTやAI、ロボティクスなどの先端商材の開発に注力 ■ コロナ禍による行動抑制により事業計画は遅延
	3 新たなビジネスモデルの構築	<ul style="list-style-type: none"> ■ ソフトウェア販売を立ち上げ ■ サブスクリプション契約やライセンスビジネスをスタート
システム事業	1 取り扱い製品の差別化	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5G通信向けの商品・サービス拡充で、ローカル5G市場の先駆者に ■ AI/IoT向け組込ボードやPCR検査キットなど時勢にマッチした商材を拡充
	2 サービスの差別化	<ul style="list-style-type: none"> ■ コロナ禍で訪問サポートが制限され、技術・サービスの提供機会が減少
	3 グループ総合力の発揮	<ul style="list-style-type: none"> ■ 製品販売と保守メンテナンスを組み合わせたワンストップサービスの提供を継続

事業環境

- ▶ 第4次産業革命と呼ばれる新たな技術革新の時代の到来でビジネスチャンスが拡大

第4次産業革命の到来による需要の増加

技術革新のさらなる加速

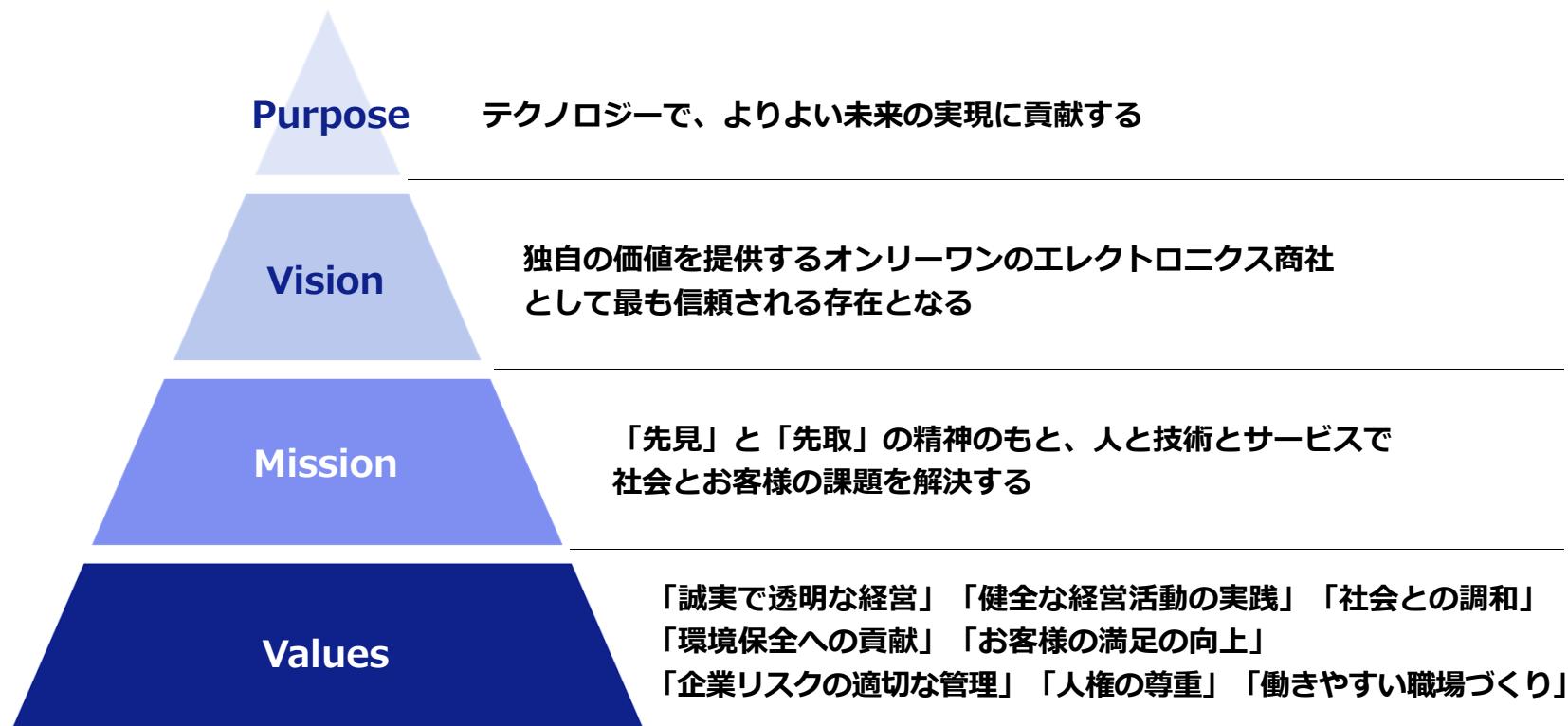
自動車のEV化や通信の高速化・大容量化などの技術革新が加速

Society5.0の実現加速

AIやIoTなどの革新技术をあらゆる産業や社会に取り入れる世界の実現に向けた動きが加速

商材×技術を融合させた新たなソリューション開発が課題

多様化するニーズへの対応や各商材を組み合わせたシステムインテグレーション機能の強化、通信技術とIoT技術を融合させた統合ソリューションの開発の推進が課題



新中期経営計画「丸文 Nextage 2024」概要

企業 スローガン

『未来をつなぐ、技術で繋ぐ。』

新中期経営計画 基本方針

■ サステナビリティ経営の推進

持続可能な成長実現に向けたESG・SDGsへの取り組みを推進し、ステークホルダーとの連携強化や課題解決型ビジネスの実践を通じ、社会的価値を追求します

■ 新たな事業領域への進出と成長基盤の構築

新市場・新領域における果敢な挑戦を通じ、新たな事業成長機会を継続的に追求します

■ 既存事業の「選択と集中」の促進とソリューション開発強化

お客様視点でのソリューション開発を加速しつつ、既存事業の「選択と集中」を通じた競争力強化を図ります

■ グループ経営の強化

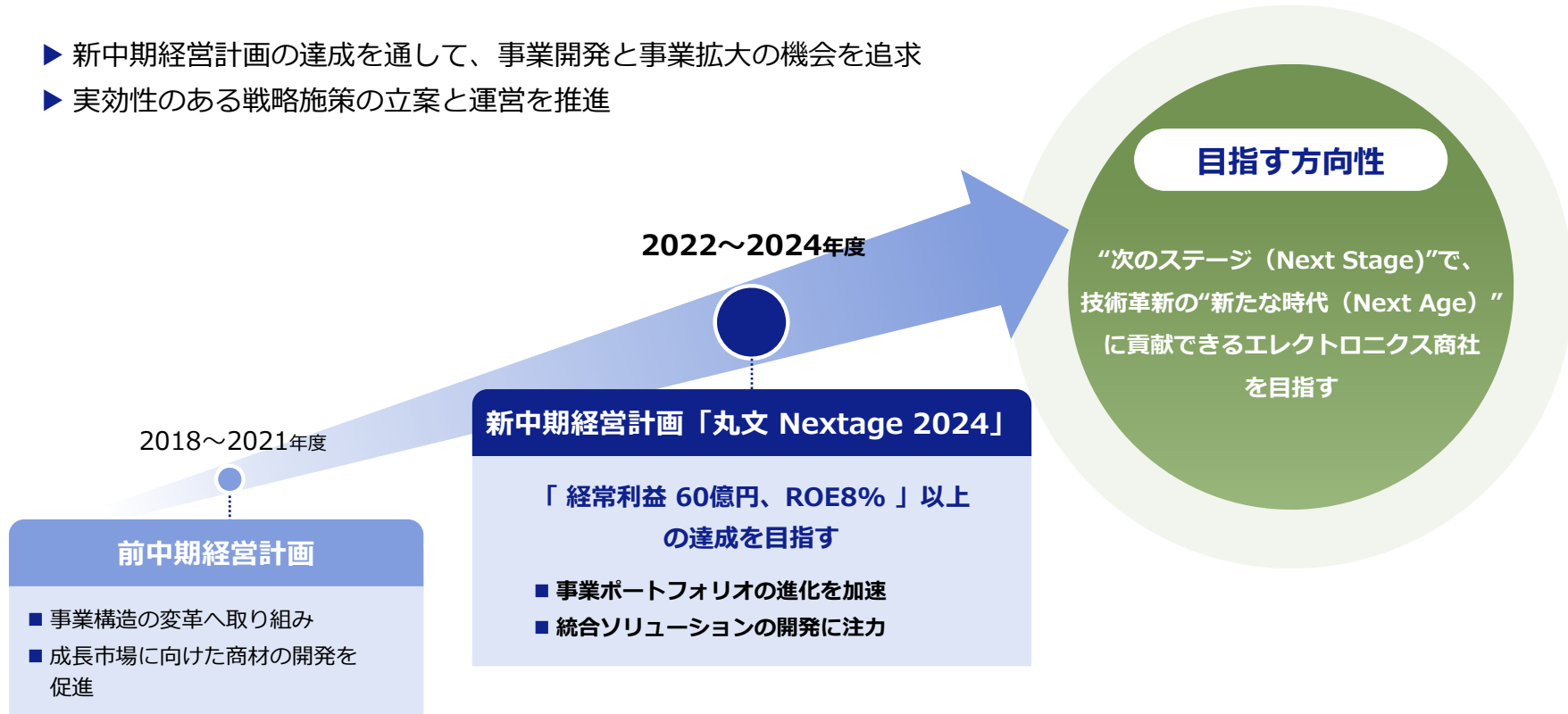
セグメント間（デバイス、システム、ソリューション事業間）連携による付加価値と国内外グループ企業間の連携によるグローバルシナジーを実現し、成果をお客様に還元します

■ 業務基盤の整備と内部プロセスの改善

業務インフラ強化や業務プロセス改善、人材育成、働き方改革により、生産性・効率性を向上します

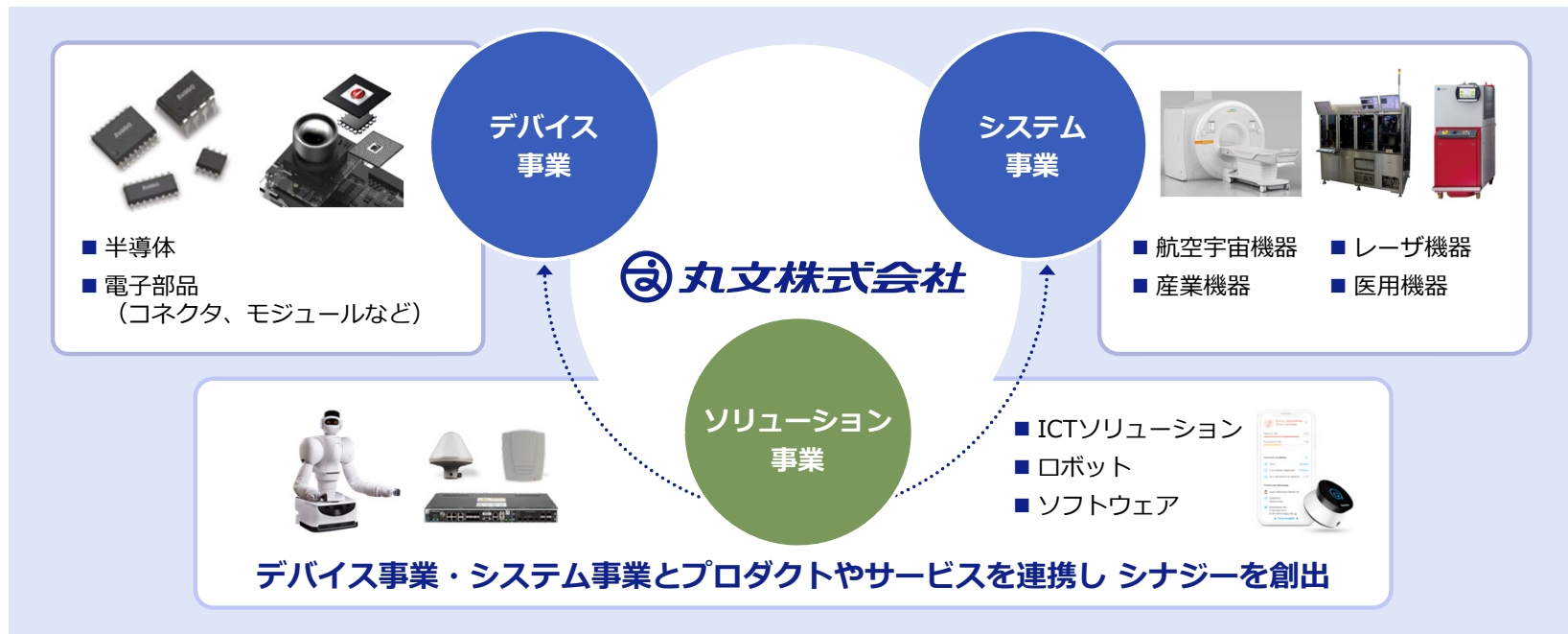
当社が目指す方向性

- ▶ 新中期経営計画の達成を通して、事業開発と事業拡大の機会を追求
- ▶ 実効性のある戦略施策の立案と運営を推進



事業セグメントの再編

- ▶ 新たにソリューション事業を新設し、3事業セグメント体制で経営を推進
- ▶ 当社の豊富な商材とAI/IoT・ネットワーク技術を組み合わせ、お客様へ新たな付加価値を提供



各事業セグメントの事業戦略 - デバイス事業 -

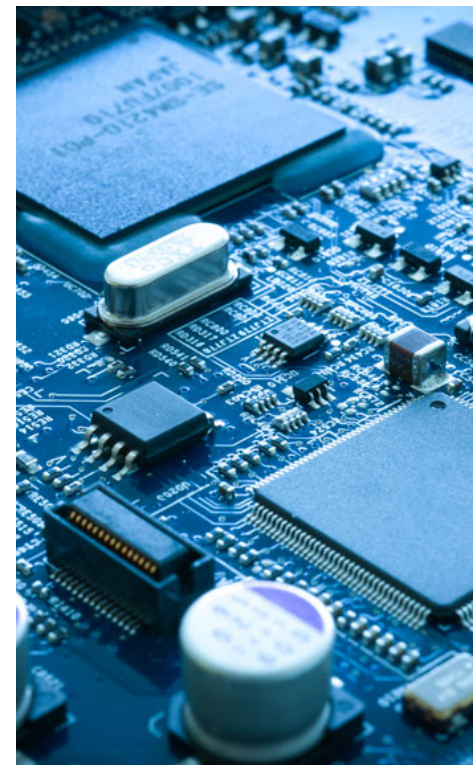
■ 新規商材・新規商権の開発推進

- ▶ 付加価値の高い新規商材の開発、新たな販売先の開拓を継続

■ 既存事業の収益性の維持・向上

- ▶ ローコストオペレーションを徹底追求し、事業の生産性と効率性を改善

(百万円)	2021年度実績	2024年度計画	計画期間の伸長率
セグメント売上高	1,174億円	1,430億円	+21.8%



各事業セグメントの事業戦略 - システム事業 -

■ 新規領域における事業規模と収益基盤の拡大

- ▶ 新規市場と新規商材の開発を推進

■ 既存領域における競争優位性の強化

- ▶ 専門性を研ぎ澄ませ、マーケットにおける確固たるポジションを確保

■ グループ連携の強化

- ▶ 丸文グループの総合力を活かしたサービスをグローバルに提供

(百万円)	2021年度実績	2024年度計画	計画期間の伸長率
セグメント売上高	484億円	630億円	+30.2%



各事業セグメントの事業戦略 - ソリューション事業 -

■ 高付加価値ビジネスの開発推進

- ▶ 成長市場に向けた革新的な商材や技術を継続的に発掘
- ▶ 有望なベンチャー企業への投資や外部パートナーとの提携機会も模索

■ 新規ビジネスモデルの構築と拡大

- ▶ サブスクリプションやライセンス販売など新たなビジネスモデルを確立

■ ソリューション開発力の向上とグループシナジーの創出

- ▶ ネットワーク/IoT技術を融合させた独自のソリューションの開発と提供を促進

(百万円)	2021年度実績	2024年度計画	計画期間の伸長率
セグメント売上高	20億円	40億円	+100.0%



経営基盤の強化

- 1 サステナビリティへの取り組みを強化し情報開示の充実を図る
- 2 デジタルマーケティングとカスタマーリレーションを強化する基盤を整備する
- 3 統合的リスクマネジメントの枠組み整備とリスクモニタリングの運用強化を推進する
- 4 プライム市場上場会社として、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図る
- 5 人材への投資、働きやすい職場環境の整備、ITインフラの整備に継続的に取り組む

財務目標

- ▶ 「連結経常利益60億円、ROE8.0%」以上を目標とし、収益性と株主資本効率の向上に取り組む
- ▶ 営業キャッシュフローは、設備投資や配当還元、負債圧縮に充当しつつ、戦略性の高いノンオーガニック成長機会の取込みや有望なベンチャー企業への投資に振り向けることも想定

(百万円)	2021年度実績	2024年度目標
売上高	1,678 億円	2,100 億円
経常利益	41 億円	60 億円以上
経常利益率	2.5 %	2.9 %
ROE	5.9 %	8.0 %以上

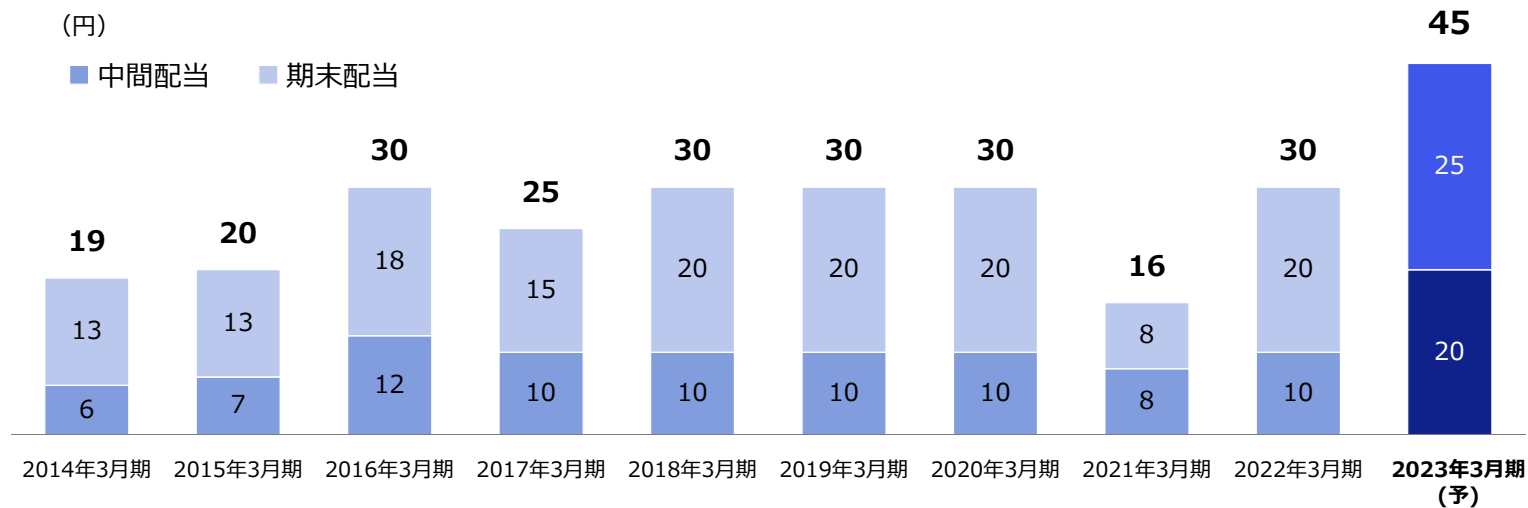
配当政策・方針

- ▶ 連結配当性向の目安を30%から40%以上に変更し、安定的かつ業績に応じた配当を実施

連結配当性向 30% → 40%

(円)

■ 中間配当 ■ 期末配当



2023年3月期 業績予想の概要

2023年3月期 業績予想

- ▶ 民生機器向け半導体や産業機器、医用機器の売上増加を見込む
- ▶ 販管費の増加により営業利益は前年度より減少するが、経常利益・当期純利益は増益の見通し

(百万円)	2022年3月期		2023年3月期		前年度比
	実績	売上比	業績予想	売上比	
売上高	167,794	—	195,000	—	+ 27,206 (16.2%)
売上総利益	20,251	12.1%	20,500	6.7%	+ 249 (1.2%)
販管費	14,257	8.5%	15,400	4.5%	+ 1,143 (8.0%)
営業利益	5,994	3.6%	5,100	2.2%	△ 894 (-14.9%)
経常利益	4,106	2.4%	4,500	1.1%	+ 394 (9.6%)
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,437	1.5%	2,900	0.6%	+ 463 (19.0%)

2023年3月期 事業別業績予想サマリ

※ 2022年3月期実績は、3事業 再編後の数値に組み替えております

■ デバイス事業

新規商権の獲得や新規商材の取り扱いによる増加を見込む

(百万円)	2022年3月期 実績※	2023年3月期 予想	前年度比
売上高	117,442	137,500	+20,058 (+17.1%)

■ システム事業

高水準の受注残をもとに産業機器や医用機器を中心に増加を見込む

(百万円)	2022年3月期 実績※	2023年3月期 予想	前年度比
売上高	48,366	55,200	+6,834 (+14.1%)

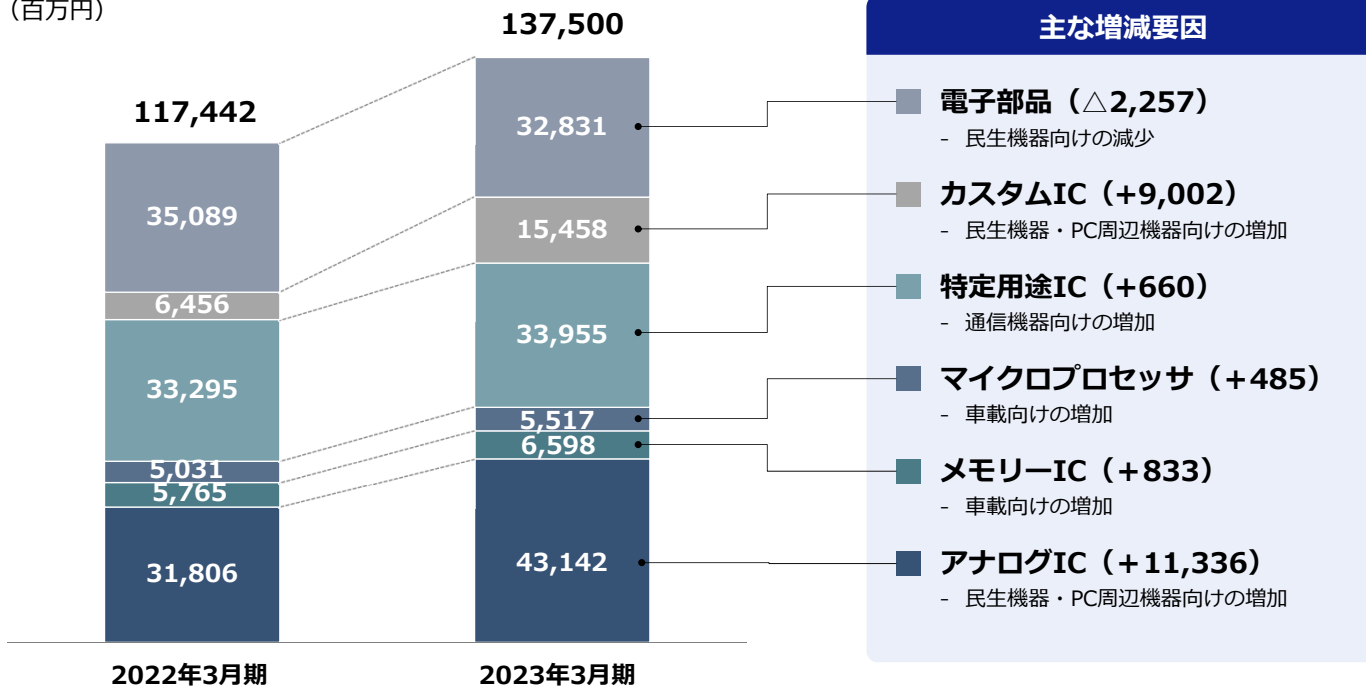
■ ソリューション事業

5G関連市場の拡大により情報通信向けの需要が伸長する見込み

(百万円)	2022年3月期 実績※	2023年3月期 予想	前年度比
売上高	1,985	2,300	+315 (+15.9%)

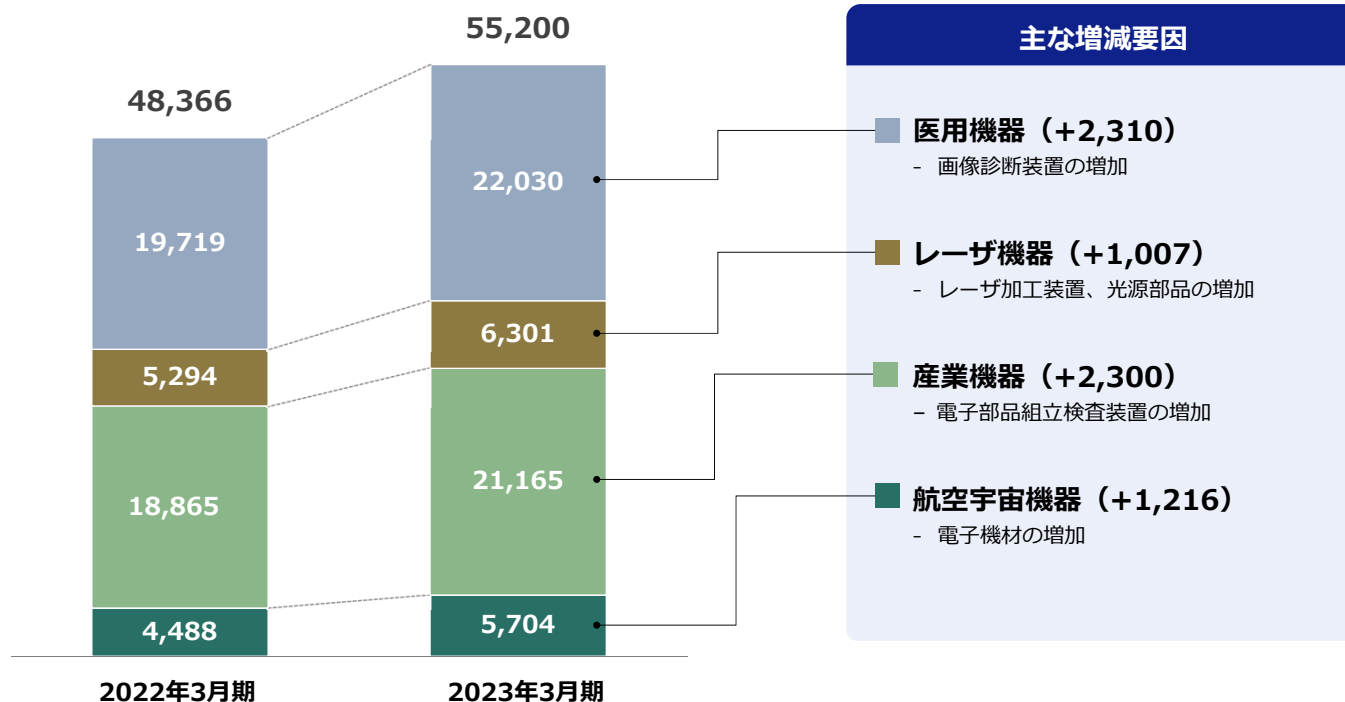
2023年3月期 『デバイス事業』 品目別売上高予想

(百万円)



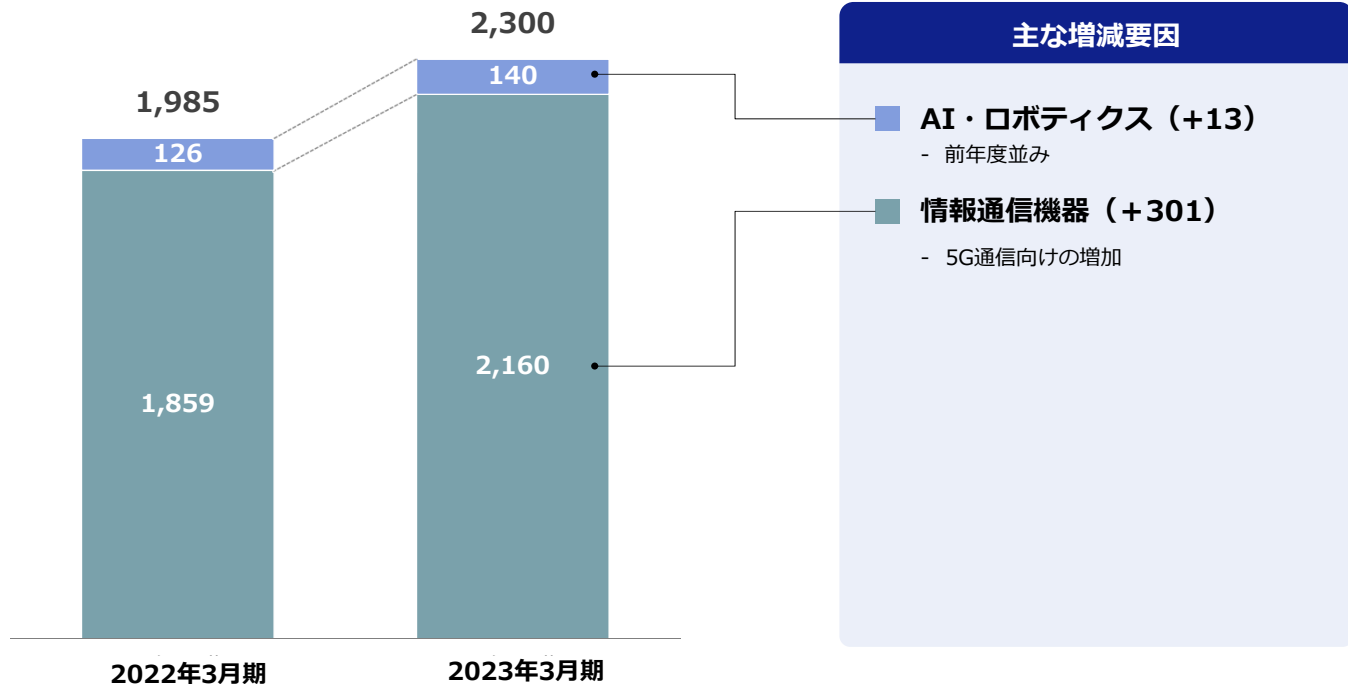
2023年3月期 『システム事業』 品目別売上高予想

(百万円)



2023年3月期 『ソリューション事業』 品目別売上高予想

(百万円)



 **丸文株式会社**

参考資料

企業概況

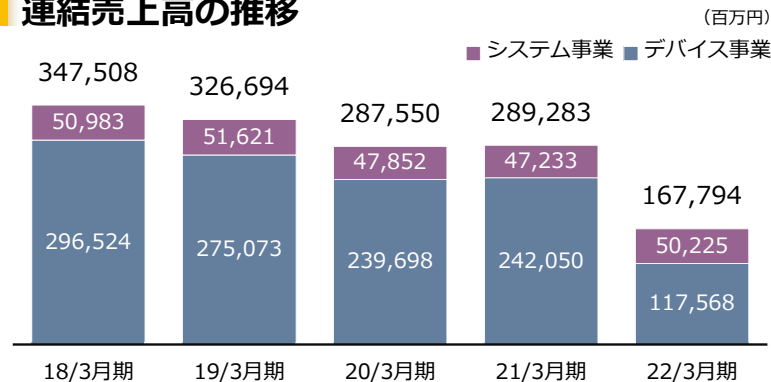
会社概要

創 業	1844年（弘化元年）
設 立	1947年（昭和22年）7月
所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
資 本 金	62億1,450万円
決算期日	3月31日
代 表 者	代表取締役社長 飯野亨
売 上 高	連結 1,677億円（2022年3月期） 単体 1,200億円（2022年3月期）
従業員数	連結 1,119名（2022年3月末） 単体 577名（2022年3月末）
株式上場	東京証券取引所 プライム市場 （コード:7537）

事業領域

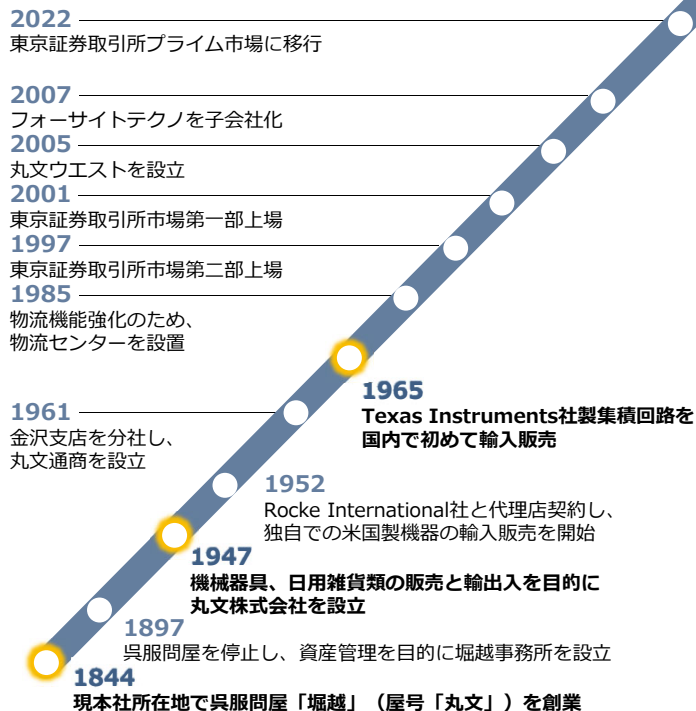
デバイス事業	システム事業	ソリューション事業
<ul style="list-style-type: none"> ■ 半導体 ■ 電子部品 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 航空宇宙機器 ■ 産業機器 ■ レーザ機器 ■ 医用機器 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ICTソリューション ■ AI・ロボティクス

連結売上高の推移

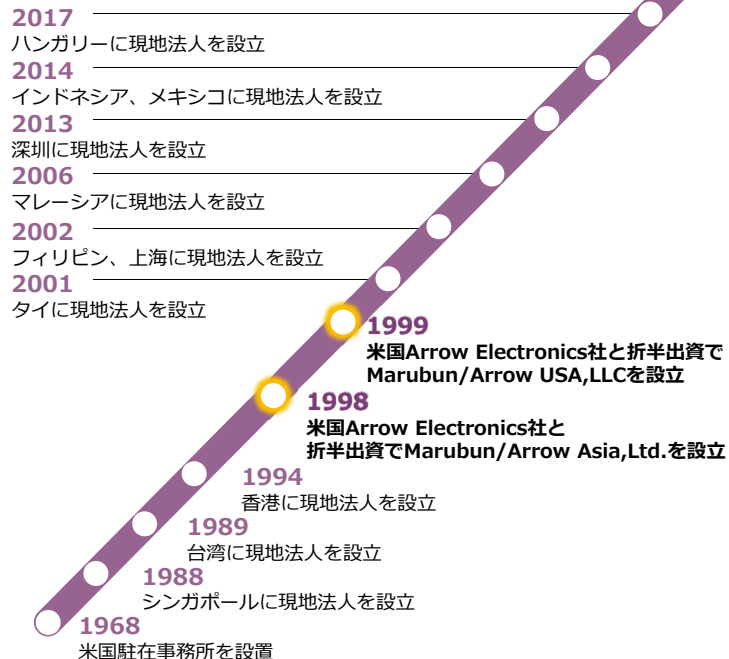


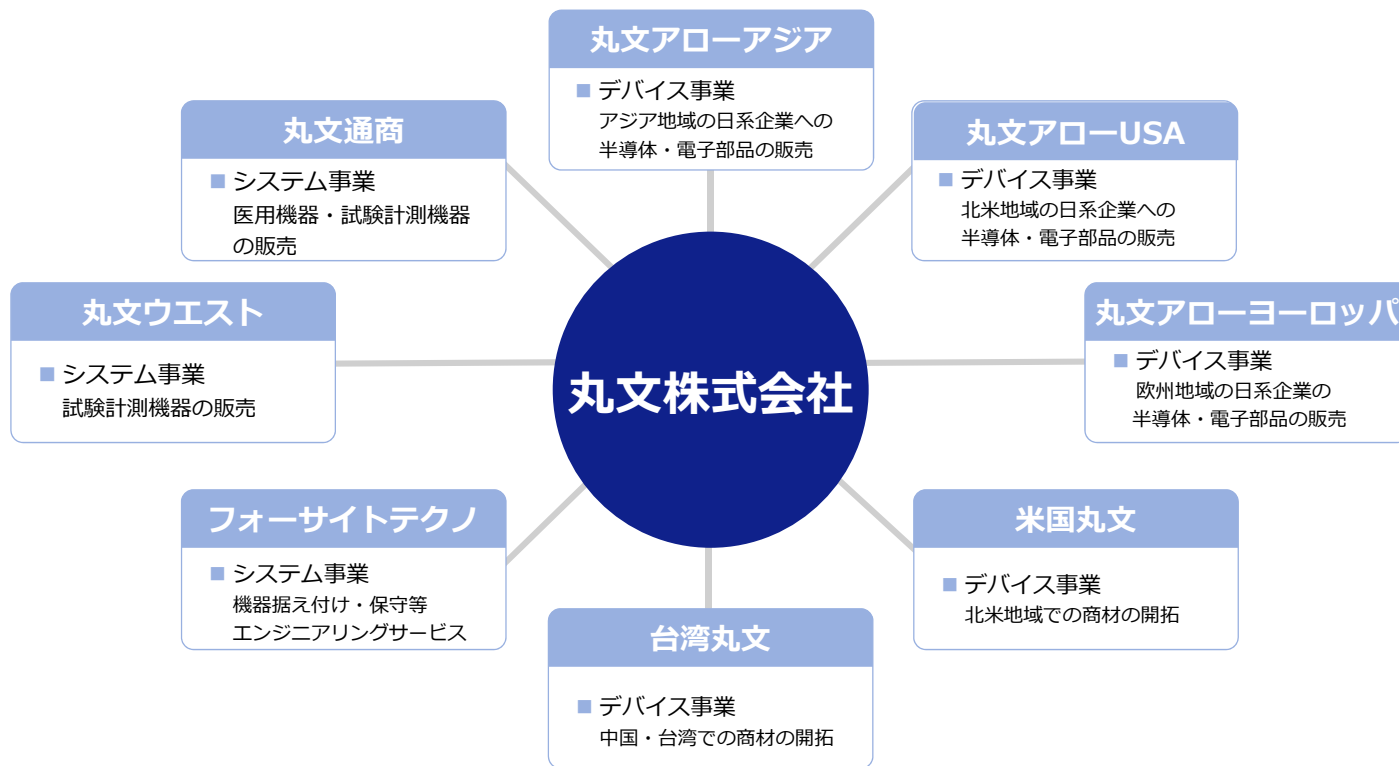
沿革

国内



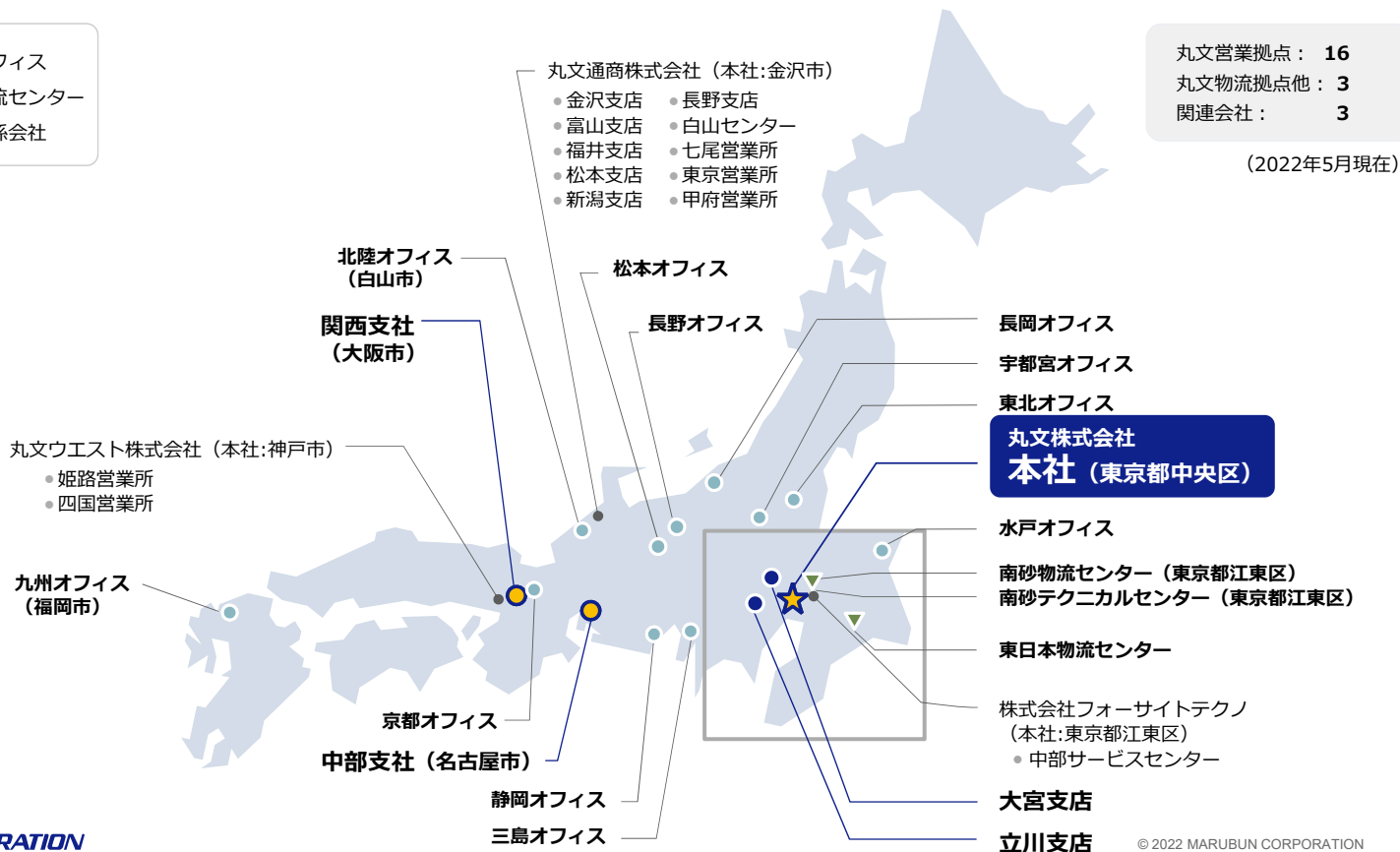
海外



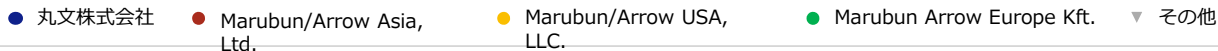
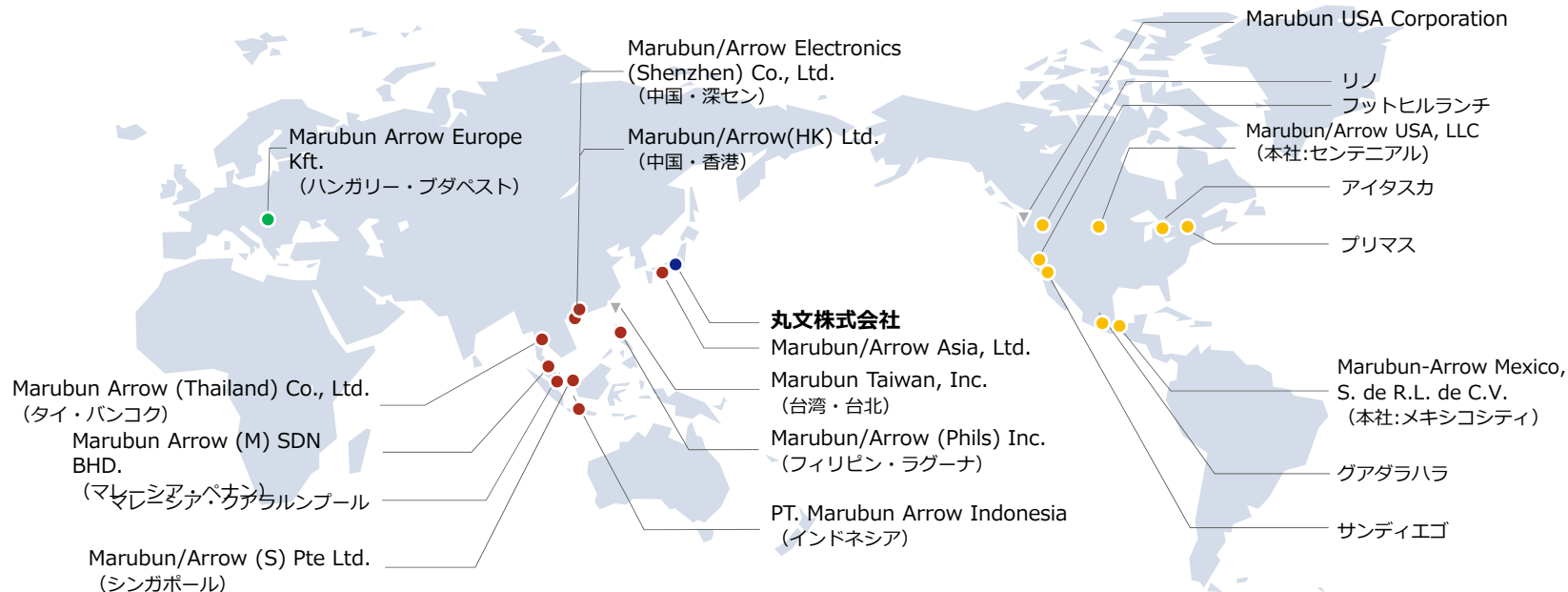


国内拠点

- ★ 本社
- 支社
- 支店
- オフィス
- ▼ 物流センター
- 関係会社



グローバルネットワーク



アジア拠点: 10

北米拠点: 9

欧州拠点: 1

(2022年5月現在)

提供価値

グローバルサポート

- アローエレクトロニクスとの協業
- 丸文アローによるワールドワイドで日本品質のサポート

豊富なラインカードと製品相互のシナジー

- 国内外の競争力のあるサプライヤをラインナップ
- 標準品からカスタムまで幅広い取扱製品

提供価値

システムソリューション

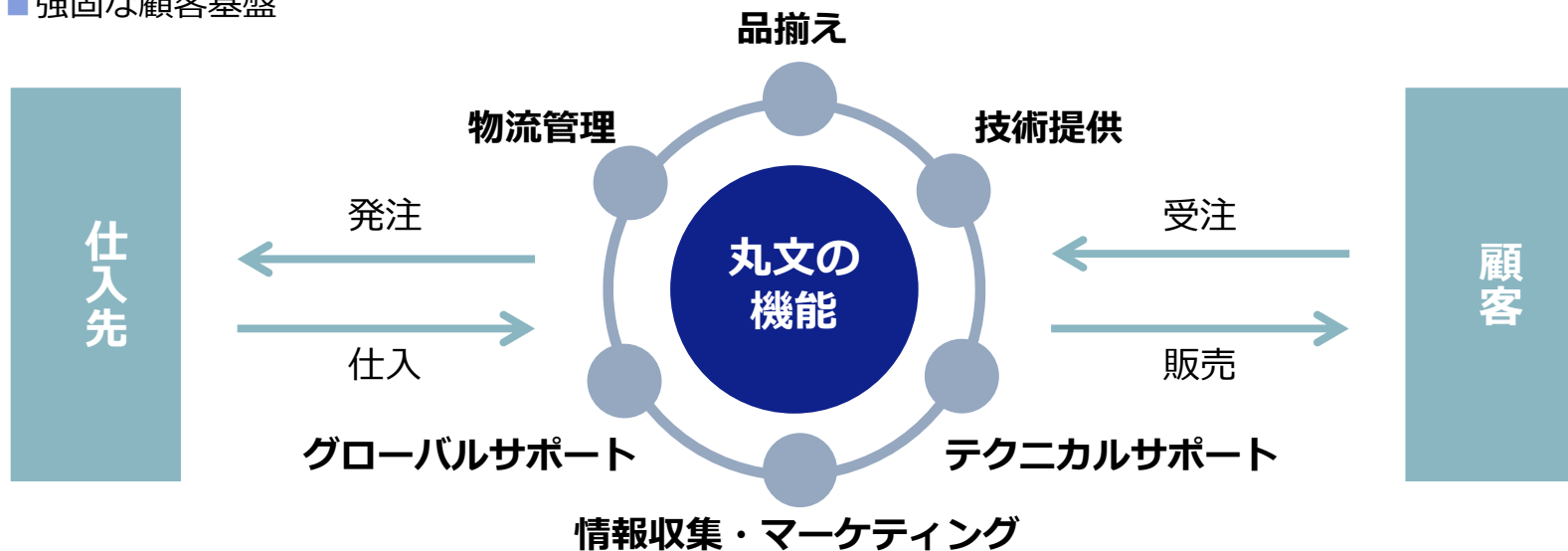
- 高い専門性をもつ強力な技術サポート体制
- 3rdパーティ、モジュールメーカー、EMS/ODM等との協業関係

長年に渡る取引で培われた強固な顧客基盤

- 国内電子機器メーカーを中心とする強固な顧客基盤

デバイス事業：特徴と強み

- 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え
- 米国アロー社との提携によるグローバルネットワーク
- 高度な技術力をもとにした商材提案力
- 強固な顧客基盤



社名	住所	設立年月	出資比率	事業内容
Marubun USA Corporation	California, U.S.A.	1983年10月	100%	丸文アローUSAの持株会社
Marubun Taiwan, Inc.	Taipei, Taiwan	1989年11月	100%	台湾製デバイスの仕入販売
Marubun/Arrow Asia, Ltd.	British Virgin Islands	1998年10月	50%	丸文アローシンガポール、丸文アロー香港の持株会社
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.	Pereira Road, Singapore	1988年3月	50%	
Marubun/Arrow (HK) Ltd.	Hong Kong, China	1994年8月	50%	
Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd.	Bangkok, Thailand	2000年10月	50%	
Marubun/Arrow (Phils), Inc.	Laguna, Philippines	2001年10月	50%	
Marubun Arrow (M) SDN BHD	Penang, Malaysia	2006年6月	50%	海外進出した日系企業への 半導体・電子部品の仕入販売
Marubun/Arrow Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.	Shenzhen, China	2013年6月	50%	
PT. Marubun Arrow Indonesia	Jakarta, Indonesia	2014年4月	50%	
Marubun/Arrow USA, LLC*	Delaware, U.S.A.	1998年11月	50%	
Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V.*	MexicoCity, MEXICO	2014年9月	50%	
Marubun Arrow Europe Kft.*	Budapest, Hungary	2017年11月	50%	

* Marubun/Arrow USA、Marubun-Arrow Mexico、Marubun Arrow Europe Kft.は持分法適用の関連会社です。

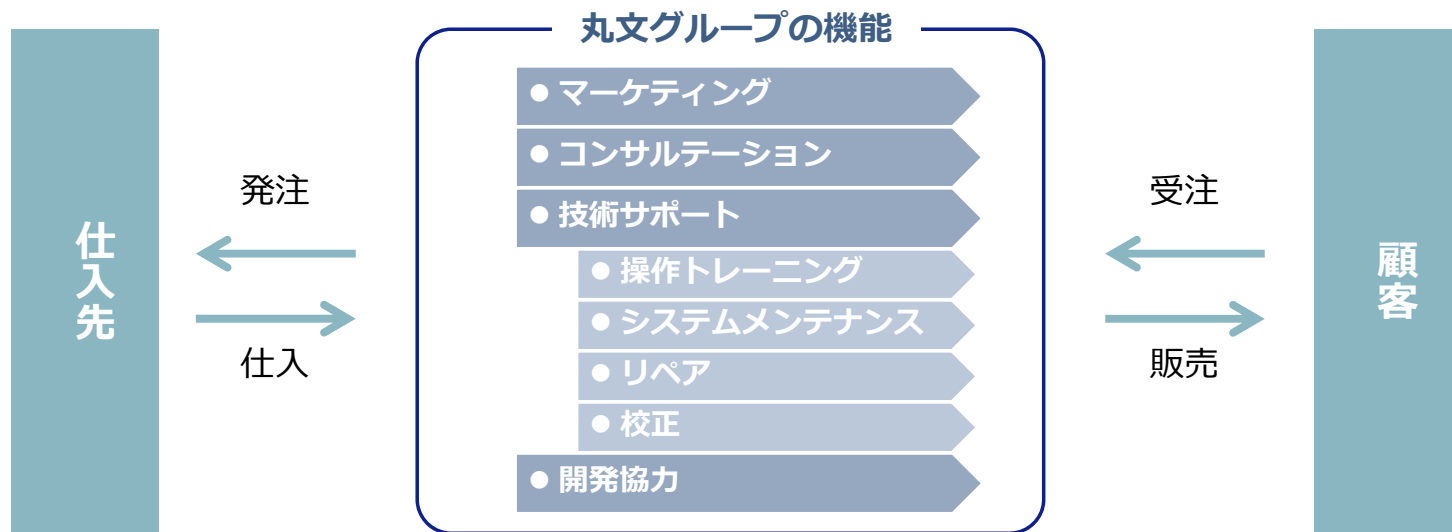
デバイス事業：主要取扱い製品

品目 主要仕入先 (アルファベット順)	半 導 体					電子部品	
	アナログIC	メモリーIC	マイクロプロセッサ	特定用途IC	カスタムIC	電子部品	その他
	標準アナログ、センサー、 ディスクリートなど	フラッシュ、DRAMなど	MPU、MCU、DSPなど	ASSP、LEDなど	カスタム、ASIC、FPGA など	ディスプレイ、水晶振動子、 コネクタ・スイッチ・基板、 IoT機器など	パワーサプライ、ボードPC、 ソフトウェア、 IPライセンスなど
エイブリック	●	●					
Afero				●		●	●
旭化成エレクトロニクス	●		●	●	●		
ATP		●					
Autotalks				●			
Broadcom	●			●	●	●	●
Cree	●						
Cypress※1		●	●	●			
Eink						●	
InvenSense	●						
ISSI	●	●		●			
GOWIN					●		
Littelfuse	●					●	
Maxim	●		●	●		●	
Microchip	●	●	●	●	●	●	
Molex						●	
MPS※2	●						
Nuvoton	●		●	●	●		
Qorvo	●			●			
セイコーエプソン			●	●	●	●	
SEMTECH	●			●			
TE Connectivity	●					●	
VANTIQ							●
VICOR							●
VISHAY	●			●			●
Western Digital		●					

*1:Cypress Semiconductor, An Infineon Technologies Company *2:Monolithic Power Systems, Inc.

システム事業：特徴と強み

- ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供
- システム提案から販売～保守メンテナンスまで、ワンストップサービスで提供



システム事業：グループ会社概要

社名	本社	設立年月	出資比率	事業内容
丸文通商株式会社	石川県金沢市	1961年3月	100%	医用機器および試験計測機器の仕入販売・修理・メンテナンス
丸文ウエスト株式会社	兵庫県神戸市	2005年5月	100%	試験計測機器の仕入販売
株式会社フォーサイトテクノ	東京都江東区	1999年3月	51%	システム製品の修理・メンテナンス、エンジニアリングサービス

システム事業：主要取扱い製品①

分野	主要取扱商品	主要仕入先
航空宇宙機器	宇宙関連機器 計測・各種センサ	日本ベーカーヒューズ（株）、 Comtech Telecommunications Corp.、PCB Piezotronics, Inc
	航空関連機器 高周波電子機器	Bird Technologies、CPI Inc、Textron Systems Corporation
産業機器	検査装置 製造装置・組立装置	アキム(株)、Ansible Motion Limited、セイコーエプソン(株)、(株)FUJI、(株)ユー・エイチ・システム
	組込ソリューション	ADLINK Technology Inc、Aitech Defense Systems, Inc.、 Artesyn Embedded Technologies Inc.、DFI、Gorilla Technology Inc.
レーザー機器	半導体レーザー レーザー加工機	Amplitude、Laserline GmbH.、nLIGHT, Inc.、NUTECH GmbH
	光学機器	Excelitas Technologies Corp.、First Sensor AG、Luminus, Inc.、United Power Research Technology Corp.、ViALUX GmbH、Young Optics Inc.
医用機器	画像診断機器	コニカミノルタジャパン(株)、(株)島津製作所、シーメンスヘルスケア(株)、 富士フイルムヘルスケア(株)
	人工透析機器	旭化成メディカル(株)、(株)カネカメディックス、日機装(株)、
	臨床検査機器	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)、ベックマンコールター(株)

システム事業：主要取扱い製品②

航空宇宙機器



BEI Sensors社
高信頼性部品



CPI社
マイクロ波電子管

産業機器



島津製作所
ガスクロマトグラフ質量分析計



アキム
電子部品組立装置



FEI社
赤外線発熱解析装置



ADLINK
BOX PC

システム事業：主要取扱い製品③

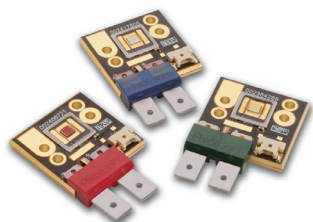
レーザー機器



nLIGHT社
組込み用半導体レーザー



Laserline社
レーザー加工装置



Luminus Devices社
光源部品

医用機器



シーメンスヘルスケア社
X線CT装置

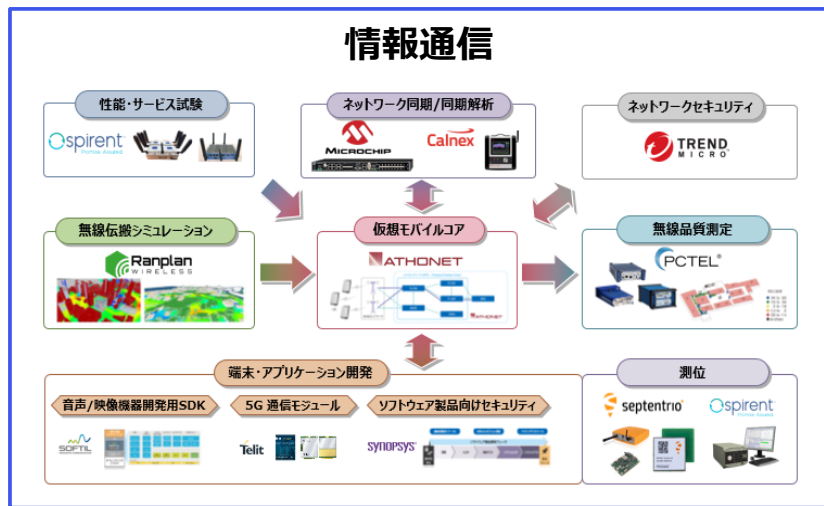
※シーメンスヘルスケア（株）ホームページより、画像引用



島津製作所
血管撮影システム

ソリューション事業：特徴と強み

- 先端技術を有するユニークな商材の販売・保守の提供
- 豊富な商材とAI/IoT・ネットワーク技術を組み合わせたソリューションの提供



AI・IoT・ロボティクス



Aeolus社
ヒューマノイド
AIロボット



OSSIA社
ワイヤレス給電
技術ライセンス

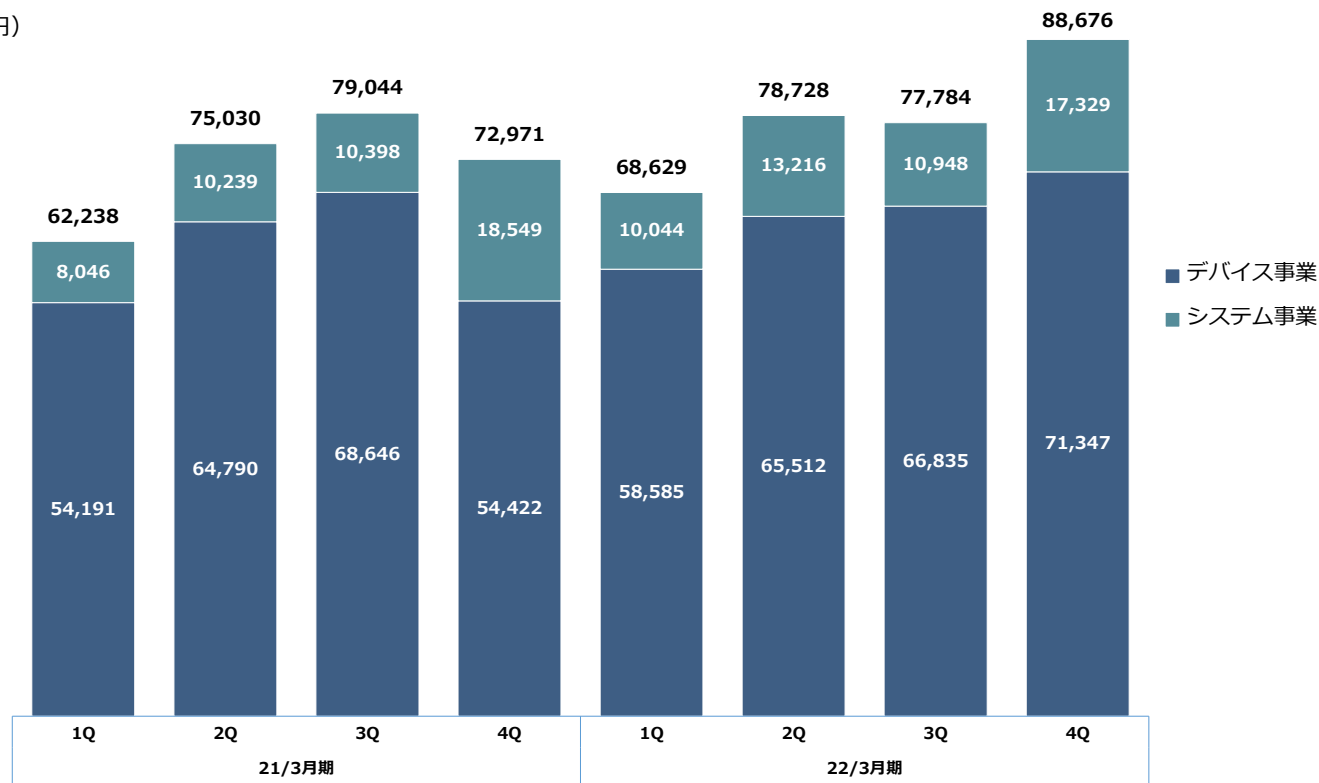


StethoMe社
電子聴診器

当社取り扱いプロダクトとサービスを連携し・事業間シナジーを創出

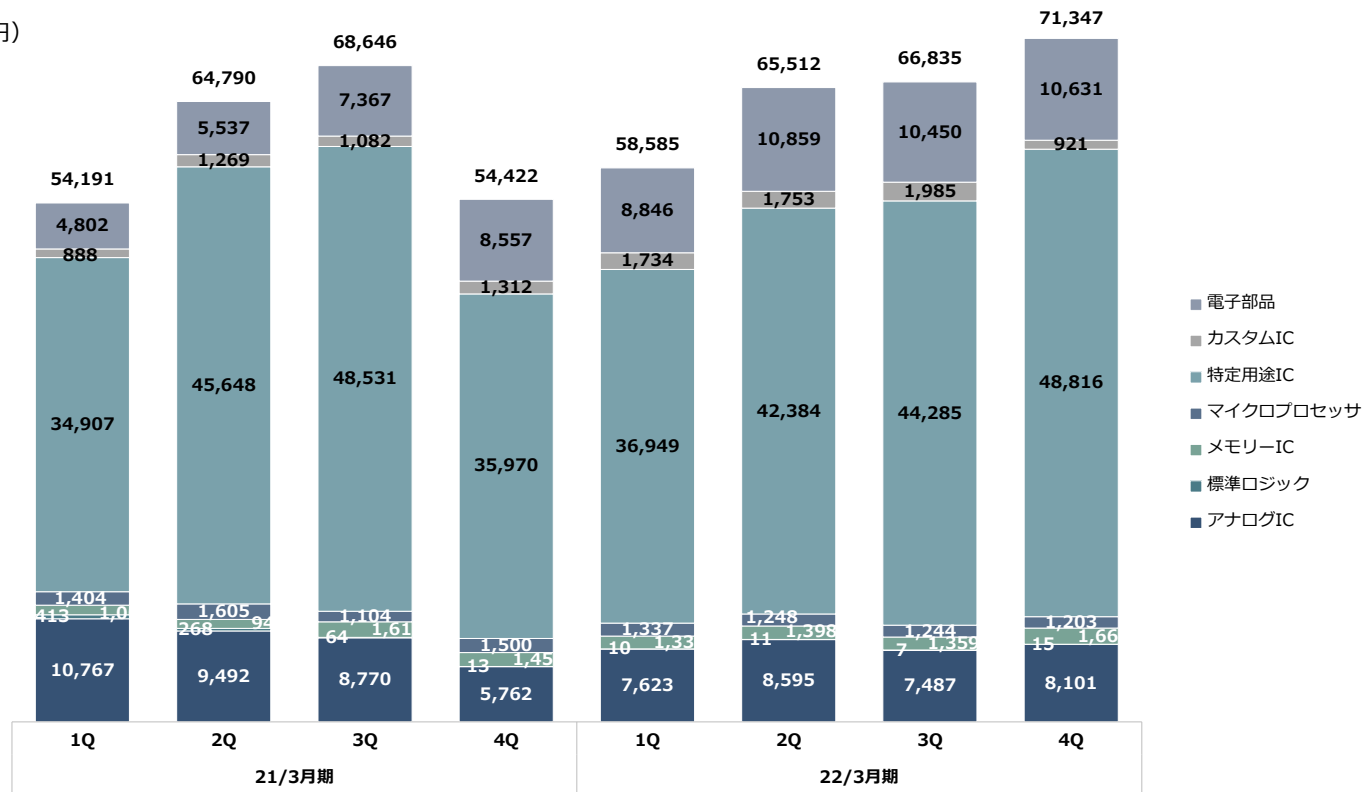
業績四半期推移（事業別売上高）

(百万円)



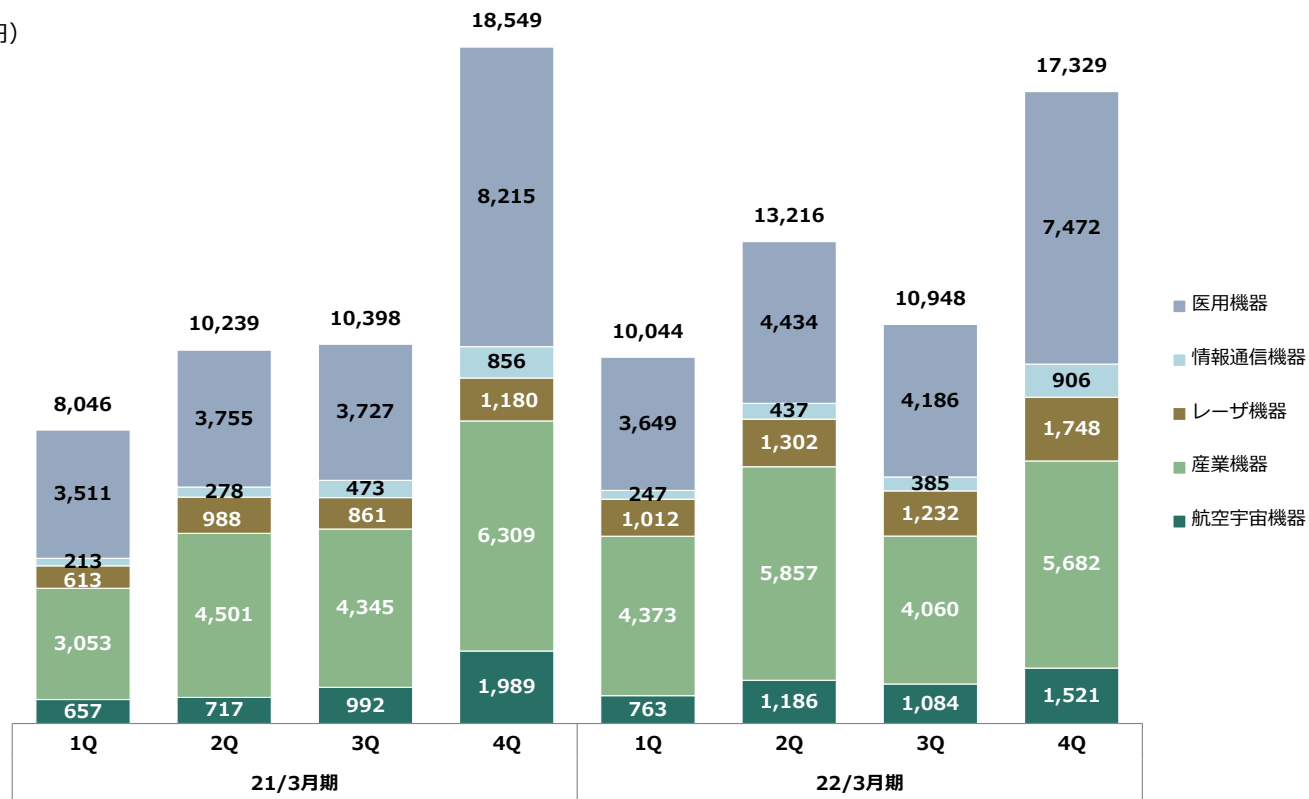
業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）

(百万円)



業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）

(百万円)



本資料お取扱い上のご注意

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により異なる可能性がありますことをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

丸文株式会社 経営企画部

E-mail : ir@marubun.co.jp